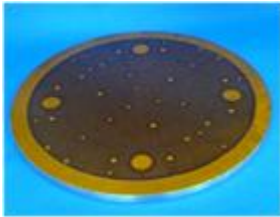
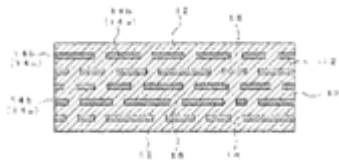




温度ムラの少ない半導体用伝熱プレート

多層伝熱プレート及びその製造方法

技術分野分類	5005：熱工学
技術キーワード	K：伝熱機器
産業分類	E-28：電子部品・デバイス・電子回路製造業

内容	概要	複数枚のチタン板とカーボンシートを積層複合化することで、耐腐食性が高くかつ均熱性に優れた伝熱プレート及びその製造技術
	従来技術・競合技術との比較 (優位性)	半導体装置の製造工程で基板の加熱処理や冷却処理では、アルミニウム製の伝熱プレートが用いられているが、腐食性のガス環境下では使えない。また、チタンは耐食性が高いものの、温度ムラが発生しやすい。そこで、複数枚のチタン板とカーボンシートを積層することで、耐食性が高くかつ温度ムラの少ない伝熱プレートを開発した。
	本技術の有用性	チタンの耐食性とアルミニウムと同等の均熱性能を有している伝熱プレート
関連情報 (図・表・写真等)	 	<p>試作品(φ300)</p> <p>断面(イメージ)</p>
適用可能製品	伝熱プレート	
技術シース保有者	氏名 所属・役職	小松 豊 材料技術部門金属材料部 研究員
技術シース照会先	窓口 TEL/FAX e-mail	技術連携部門 026-268-0602 / 026-291-6243 gijuren@pref.nagano.lg.jp

- 知的財産 特許出願 (特願 2009-176551) 【日本電熱㈱との共同出願】
「多層伝熱プレート及びその製造方法」
- 試作品状況 無 提示可 提供可

作成日 2012 年 11 月 22 日